TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員申請辦法

民國 112 年 9 月 15 日修訂

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出具博士學位之新進研究人員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項:

「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」一至二名，頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 10 萬元整。

三、申請資格：

下列大學新進研究人員(含教師、研究人員、博士後)取得博士學位後 5 年內，在台灣學校從事研發及教學滿 2 年，以申請截止日為基準。2022 年度起從國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，北科大、台科大與高科大共十一所大學之傑出新進研究人員中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

四、申請時間：

本會於每年 10 月中旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為每年 10 月 15 日至 12 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委或委任，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於次年之本會會員大會或年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。因故經 TSIA 遴選委員會同意，理監事會核備，同意由其指導教授或該單位最高研發主管出席，受獎得改由他人代之。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

各校可推薦最多 3 名研究員。若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)（**此為最重要文件，請務必簡潔明確**）。

9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。

9-3 身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。**(為保護個資，請自行加註”影本僅限 TSIA 辦理半導體獎申請使用，禁止其他用途“。)**

9-4 工作服務證明正本。

9-5 取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。

9-6 申請文件請掃瞄為單一 PDF 檔案後，上傳至申請表內之申請資料連結網址，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

張世杰 TSIA 遴選委員會總幹事/國立清華大學教授
電話：(O) 03-574-2964
地址：新竹市 30013 光復路二段 101 號
國立清華大學 資訊工程學系
Email Address: scchang@cs.nthu.edu.tw